

CMI165®

独特的带有温度补偿的表面铜厚度测量

了解更多信息

这些仪表是我们的 XRF 镀层分析仪的出色补充。
如需下订单，请联系

contact@hitachi-hightech-as.com

更多信息

如需了解有关 CMI165M® 或 PCB 仪表系列的更
多内容，请访问

www.hitachi-hightech.com/hha



在不考虑铜温度的前提下获得准确的检验结果

温度会影响对铜样品的准确测量。我们的 CMI165® 可对温度实施补偿，在不考虑铜温度的前提下获得准确的检验结果。这是对如下流程实施质保和检验的理想工具：

- | PCB 制造和装配。
- | 面铜厚度。

我们的 CMI165® 仪表具备通用性和便携性。该产品配备有保护罩，其耐用性设计可应对最为严苛的工作环境。CMI165® 是如下方面的理想之选：

- | 测量冷热 PCB 上的铜。
- | 无需取样，减少浪费。
- | 测量铜箔或覆铜板上的铜厚度（以微米、密耳或盎司为单位）。
- | 在进货检验期间按重量排序铜，之后再实施钻孔、剪断或电镀处理。
- | 在实施蚀刻或平坦化处理之后量化铜厚度。
- | 确认 PCB 面铜厚度。
- | 在不使用标准片的情况下测量最薄蚀刻铜箔厚度达 204 微米。

关键特色：

- | 温度补偿。
- | 耐用性设计。
- | 专用的 SRP-T1 可更换探针。
- | 带照明的探针，便于轻松定位。
- | 采用英语或简体中文的用户界面。

可靠的
无损的
分析
无需考虑铜箔温度



专有的 SRP-T1 测量探针

- 更换的探针 – 无需校准。
- 确保不会产生停机。

规格

- 采用阻抗法的 4 点式电探针，确保符合 EN 14571。
- 具备高度的可再现性和可靠性。
- 统计分析结果包括记录的数据、平均值、标准偏差和上下限。
- 出厂时已经过校准和认证。
- 可定制以满足特定应用。
- 可实施单点或连续模式测量。
- 通过 AA 电池提供电能。

PCB 仪表比较图

我们提供多种用于 PCB 行业的 PCB 仪表，根据您的应用需求，为您带来最具成本效益的最佳解决方案。请参考下面的比较图，或者通过 contact@hitachi-hightech-as.com 联系我们以获得专家建议。

	CMI95M	CMI165	CMI511	CMI563	CMI760
技术	微电阻	微电阻	电涡流	微电阻	微电阻
铜箔	●	●		●	●
覆铜板	●	●		●	●
铜 – 表面		●		●	●
铜 – 细线		●		●	●
孔壁铜			●		可选
温度补偿		●	●		ETP 探头
更换探针		●		●	SRP-4 探头
单位选择	盎司或微米	密尔或微米	密尔或微米	密尔或微米	密尔或微米
铜厚度范围					
微米	8 个指示灯: 5-140	化学铜: 0.25-12.7 电镀铜: 2-254	2-102	化学铜: 0.25-12.7 电镀铜: 0.25-152	面铜: 0.25-254 孔铜: 1-10
密尔		化学铜: 0.01-0.5 电镀铜: 0.1-10	0.08-4	化学铜: 0.01-0.5 电镀铜: 0.01-6	面铜: 0.01-10 孔铜: 0.08-4

我们的全球服务中心网可以为您正常工作提供全面的技术支持：

我们在电镀厚度校准和标准方面已获得 A2LA 认证*，这意味着您的 CMI165® 将符合 ISO 规范。

*A2LA 认证适用于由 Hitachi High-Tech Analytical Science America, Inc. 执行的工作。



如果您想了解关于 CMI165® 仪表的更多信息，请访问 www.hitachi-hightech.com/hha，或者通过 contact@hitachi-hightech-as.com 发送电子邮件给我们的专家之一以预定演示。

Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归 Hitachi High-Tech Analytical Science 所有。本出版物仅提供概要性信息，除非本公司书面同意，否则不得为任何目的使用、应用或复制这些信息，这些信息也不得构成任何订单或合同的一部分或将其视为与相关产品或服务有关的陈述。Hitachi High-Tech Analytical Science 的政策将不断完善。本公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供应条款的权利，恕不另行通知。

Hitachi High-Tech Analytical Science 承认所有商标和注册。

© Hitachi High-Tech Analytical Science 版权所有，2017 年。保留所有权利。

